

技術資料

EP-20-L06B

絕緣密封膠

簡介:

EP-20-L06B 適用於鋼板印刷製程。主要用於壓合/封蓋、MEMS 封裝等。可用於黏著 LCP/PCB/玻璃/金屬/陶瓷等基材。應用於手機元件，傳感器等。

特徵:

- 適用於印刷製程
- 基板不易翹曲
- 無溶劑型

硬化前特性	測試條件	測試方法
外觀 黑色	目視	
黏度 @ 25°C 80000 cps	Brookfield DV-III/CP-52 @ 5rpm	FT-P006
搖變指數 6.5	Brookfield DV-III/CP-52	FT-P008
@ 25°C	Visc @ 0.5rpm/Visc @ 5rpm	
細度 <20µm	細度計	FT-P025
使用壽命 @ 25°C >8 小時	黏度升高 25%@ 5rpm	FT-P024
保存期限 @-40 °C 6 個月		FT-P018
硬化條件	測試條件	測試方法
建議硬化條件	30 分鐘 @ 175 °C 60~90 分鐘 @ 150 °C (依實際膠體厚度增減)	
機械性質	測試條件	測試方法
LCP 推力 @ 25°C >2.5 Kg	LCP(4*1.5mm)/PCB	FT-M012

p.s.此表僅為 Feedpool 實驗室測試數據，投入生產前客戶仍需要針對產品做完整的驗證測試。

EP-20-L06B**絕緣密封膠**

物理化學性質	測試條件	測試方法
玻璃轉移溫度(Tg) 167 °C	DMA 3 點彎曲模式	FT-M014
熱膨脹係數 < Tg 35 ppm/°C > Tg 89 ppm/°C	TMA 膨脹模式	FT-M016
儲存模數 @25°C 4162 MPa @150°C 981 MPa @250°C 196 MPa	DMA 3 點彎曲模式試片厚度 <1.5 mm	FT-M019

p.s.此表僅為 Feedpool 實驗室測試數據，投入生產前客戶仍需要針對產品做完整的驗證測試。

運用指導方針**運輸**

運送過程皆放入乾冰或低溫冰袋等低溫保存並放置溫度指示劑以確保產品品質。當您收到貨品時發現已無乾冰殘留（或溫度指示劑呈現液態），請立即拍照存證勿使用並立刻通知我司營業人員。

解凍處理

解凍時，請將針筒（瓶、罐）直立解凍，直到完全達室溫時才能使用(一般包裝回溫時間60分鐘)，請擦乾解凍時凝結在包裝外的水氣；不可反覆解凍及冷凍以防止異常分離現象及氣泡等之產生。

儲存條件

當您收到貨品時，請立即以低溫（-20°C 或 -40°C）儲存。由於不同溫度下之保存將影響產品的壽命（保存溫度與產品壽命成正比）